



汎銓科技 半導體產業高階製程領航者
www.msscorks.com



汎銓科技股份有限公司

2024年上半年 營運概況

- This report contained herein is the exclusive intelligent property of MSSCORPS CO., LTD and shall not be distributed, copied, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior permission.
本報告為汎銓科技股份有限公司之智慧財產權，非經本公司書面授權許可，不得透露或使用本報告，亦不得複印、複製或轉變成其他任何形式使用。
- The results in this report are solely based on data, information, and/or samples provided by the applicant. All contents in this report shall be treated as whole, separated usage (texts or images) is invalid.
本報告僅就委託者之委託事項提供分析結果，報告分離使用無效。
- This report is for reference only. Please consult MSSCORPS CO., LTD first for other purposes, such as advertisement, sales promotion, notarial, or lawsuit.
本報告所載事項僅作參考資料，若貴公司擬作為廣告、商業推銷、公證、法律訴訟之用途，請先諮詢本公司同意。

免責聲明 Disclaimer

- This presentation includes forward-looking statements. All statements, other than statements of historical facts, that address activities, events or developments that Material Science Service Corp. expects or anticipates will or may occur in the future (including but not limited to projections, targets, estimates and business plans) are forward-looking statements.
- MSS's actual results or developments may differ materially from those indicated by these forward-looking statements as a result of various factors and uncertainties, including but not limited to market demand, change in legal, financial and regulatory frameworks, government policies, financial market conditions, and other risks and factors beyond our control.
- MSS does not undertake any obligation to publicly update any forward-looking statement to reflect events or circumstances after the date on which any such statement is made or to reflect the occurrence of unanticipated events.

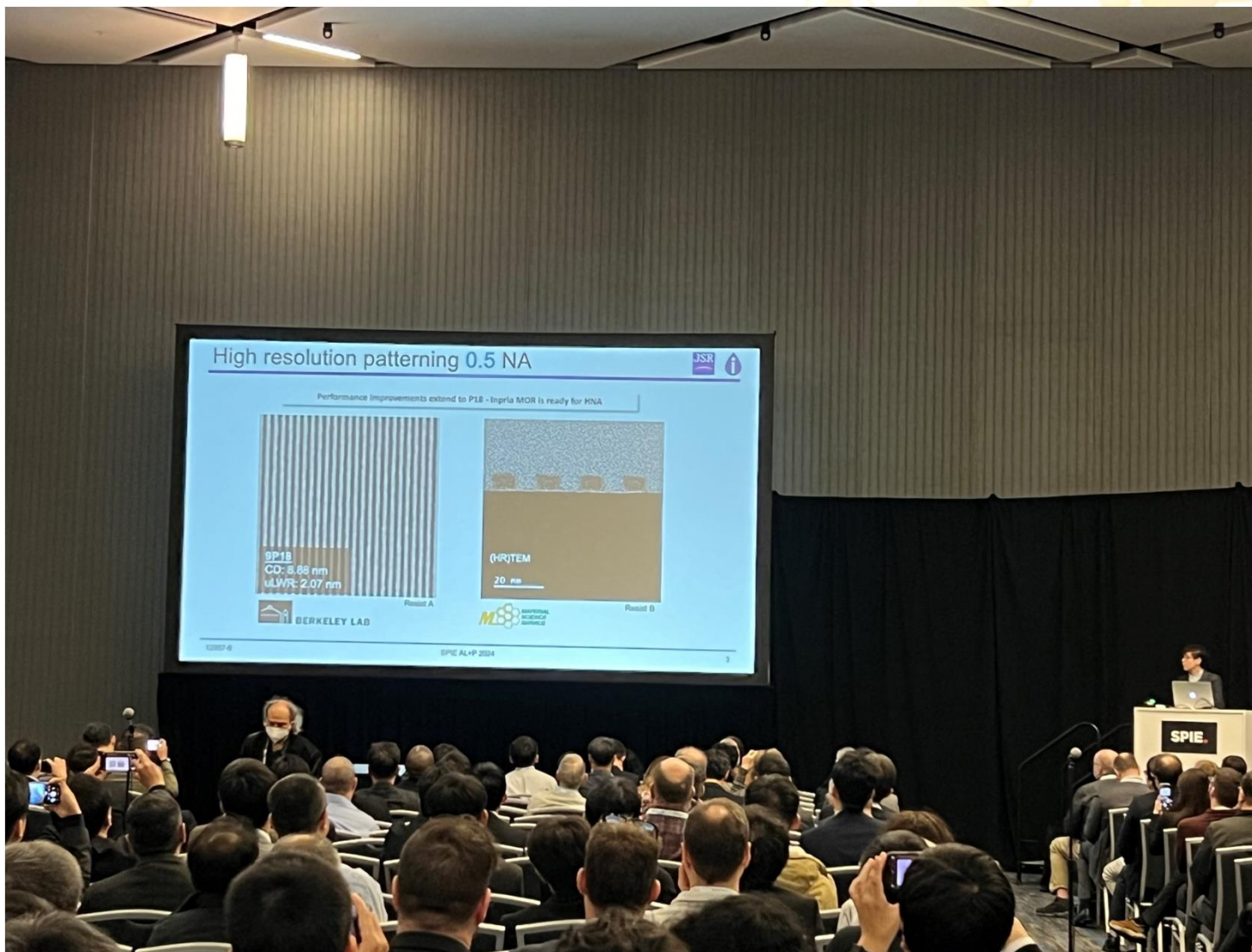
以汎銓角度看目前「分析檢測市場」

- 台灣先進製程委案需求持續增加，**進入 A⁰ 世代**
- 台灣成熟製程&化合物半導體需求市況不佳
- IC設計公司受庫存去化調整，導致研發開新案需求減緩
- **矽光子/AI 世代**

汎銓分析技術分類與成長性

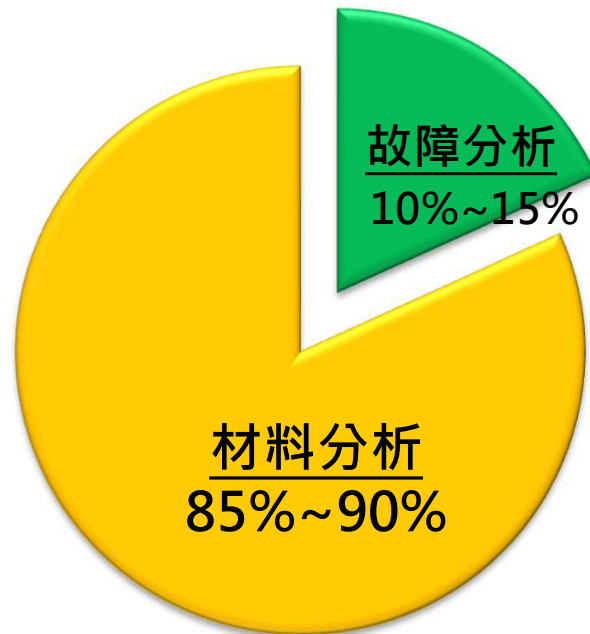
分類	屬別	技術名稱	MSS 強項	說明	業績比例	2025年預期成長性
先進製程 (A ⁰ 世代)	MA	光阻保護技術	第三代EUV光阻保護技術	金屬氧化物光阻	65%	
	MA		先進光阻保護技術	EUV光阻/蝕刻 結構分析		
	MA		選擇性沉積試片製備技術	特殊ALD 鍍膜		
	MA	low-k 保護技術	BEOL: low-k 結構保護技術	應用材料發表 black dimand 材料		
	MA		BEOL: low-k 介電損傷分析技術	low-k介電質成分分析		
	MA		新穎二維(2D)材料分析方式	弱鍵結材料分析		
	MA	超薄試片工法	超薄試片保護工法	2nm/A14 元件結構分析		
	MA		FEOL: GAA 蝕刻副產物價態分析	2nm/A14 元件成分分析		
	MA		MEOL: ALE 蝕刻副產物比較平台			
	MA	自動量測	高深寬比結構TEM分析技術	DRAM cell 分析		
MA	利用人工智慧運用於自動量測的方式		大量/可靠/精準量測			
成熟製程	MA	透鏡球高/透鏡 defect	光學元件分析技術: 透鏡球高/透鏡defect	CIS	16%	
	MA	defect	穿戴式裝置AR/VR產品鏡片整合分析	Meta Lens/Pancake Lens		
	MA	化合物半導體	磊晶缺陷量化分析技術	GaN on Si		
	MA		化合物半導體中載子濃度分佈影像	GaAs/InP/SiC		
	MA		整合型應力分析技術	PA放大能力(繞射圖案分析)		
	MA	OLED	超低對比結構材料分層顯像技術	高分子影像分析		
	MA	CCL/FCCL	軟性材料切片技術	無刀痕/void		
MA		一般材料分析(SEM/FIB CS/Reversed MA/SIMS)				
IC 故障分析	FA	化合物半導體	高壓高溫量測 (1000V 300C)	GaN/SiC	12%	
	FA		電性超薄樣品製備技術	GaN/GaAs/SiC/3nm HPC InGaAs電測技術		
	FA	電路修補技術	訊號引線技術	拉線直接量測IC 內單一邏輯閘功能		
	FA		Backside訊號引線技術	先進製程 IC		
	FA		外掛多顆被動元件技術	WLCSP/FO IC 專用		
	FA		精準去除局部RDL技術	Flipchip IC		
	FA		一般故障分析 (decap/delayer/電性/CRD/IC Reverse/SAT/3D Xray)			
矽光子	MA	矽光子結構	矽光子大面積快速切削工法	矽光子TEM分析需要精準去層與PFIB以提升產能	3%	
	MA		矽光子精準定量面積與去除層次切削	提升大片oxide/nitride 導電率		
	MA		矽光子導電製備手法	降低波導元件所造成的窗廉效應		
	FA	矽光子光電測試	矽光子低刀痕切削工法			
	FA		矽光特性、光衰的檢測	矽光檢測平台測試時，發射光進入矽光IC，耦合導光進入IC 內波導，再經過不同元進行 分光/濾光/極化 等功能		
	FA		矽光子矽光路異常定位、斷路、漏光檢測	12吋矽光子光測平台，具備全自動對光掃描		
AI 晶片	MA	先進封裝	TSV樣品製備及分析技術	CoWoS TSV 尺寸深數十um，一次需幾個TEM 觀察	4%	
	MA		hybrid metal bond 分析技術	3D IC bond 對準/接面氧化物 TEM		
	MA		Hydra PFIB	先進封裝前處理專用		
	FA	先進製程IC故障分析	IC全平面去層次技術/3nm製程去層次技術	製程結構厚度縮小/Plasma delayer		
	FA		E-beam probe 使用離子束前製備技術	超薄樣品for特別客戶電測需求		
	FA	(5nm/3nm)	通過3家科技公司在3nm產品上的驗證	um to nm 定位，nano probe 直接量測device		
	FA	先進封裝	大型IC封裝與載板分離技術	專利保護		
FA	THZ-TDR 斷路/Thermal xyz 定位/3D Xray		5um 精準定位			

□ 參與下一代high NA EUV 曝光機使用MOR (金屬層氧化物)EUV 光阻的研發

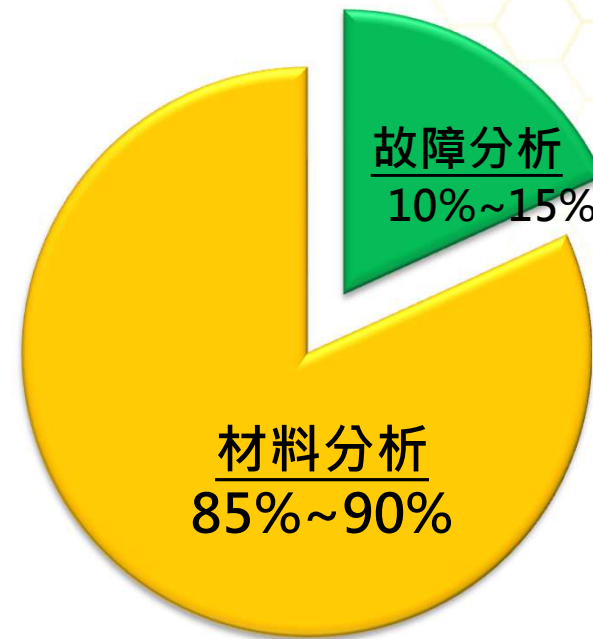


近期法人關注議題~產品組合變化

2023 H1

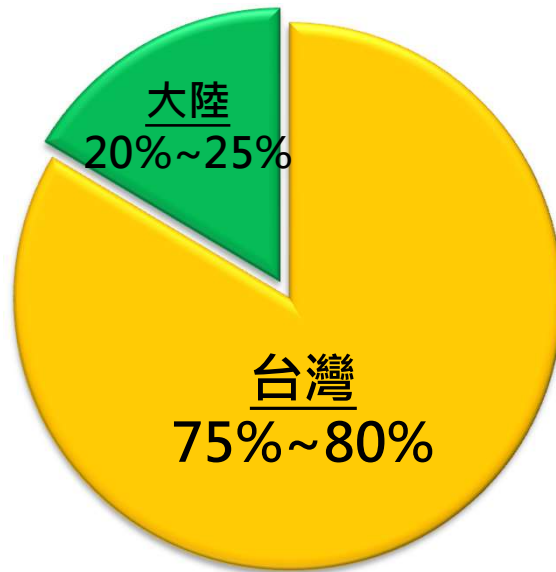


2024 H1

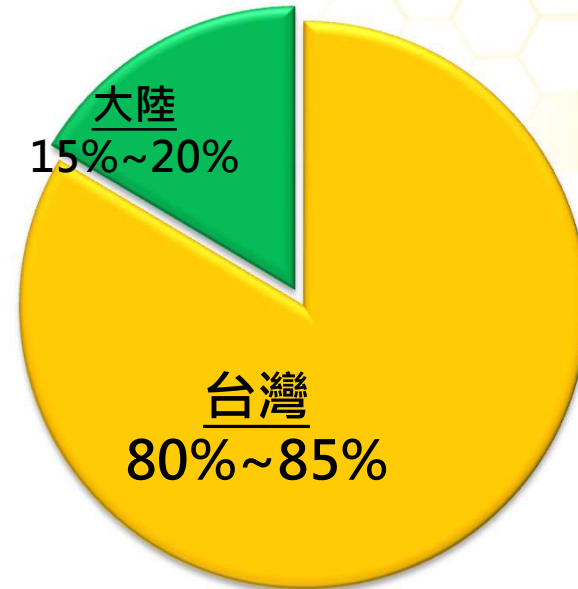


近期法人關注議題~市場組合變化

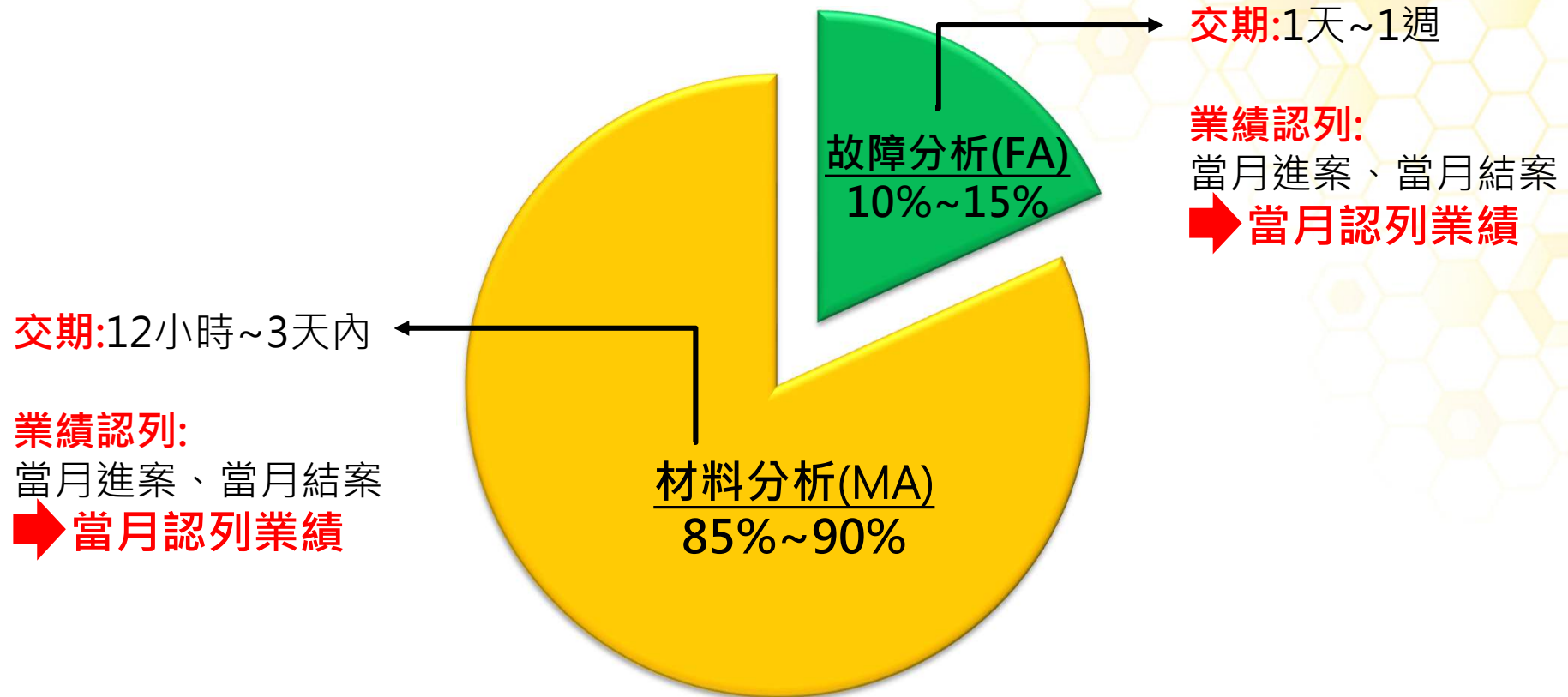
2023 H1



2024 H1



產品組合-2024H1



近期法人關注議題~人數變化

2023H1 VS 2024 H1

季度	Q1	Q2	Q3	Q4
2023	506	530	560	600
2024	610	620	-	-

近期法人關注議題~海外佈局進度

一、日本：

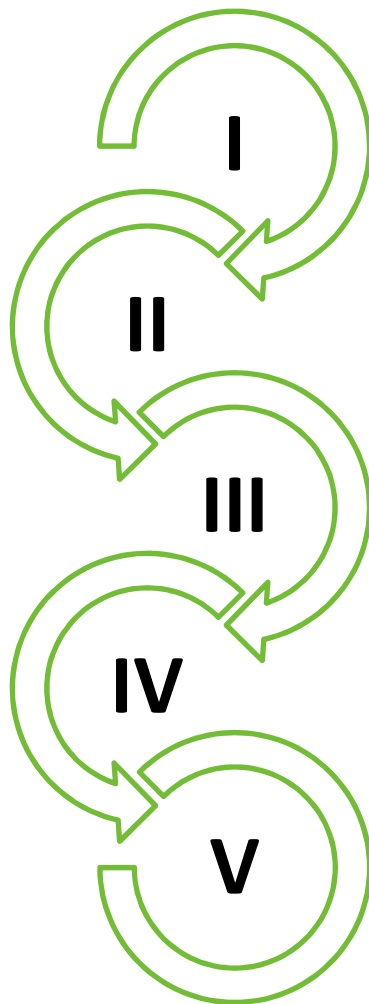
- 原本預計**2024/Q2前**MSS日本營運據點正式啟用
- 延宕至**2025/Q2前**原因為實驗室施工法規要求嚴謹

二、美國

- 預計**2025/Q2前**MSS USA營運據點正式啟用

附錄、公司簡介

公司基本資料



汎銓科技股份有限公司
MSSCORPS CO.,LTD.(英文簡稱:MSS)

設立時間: 民國94年7月27日

上市掛牌: 民國111年8月31日

創辦人: 柳紀綸董事長兼總經理

資本額: 新台幣5.18億元/員工: 620人

服務項目: 材料分析服務(MA)、故障分析服務(FA)

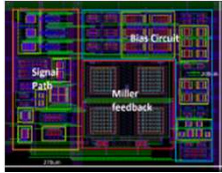
汎銓在半導體產業鏈扮演的角色-FA

項目&定位

內 容

故障分析
服務
(IC產品醫院)

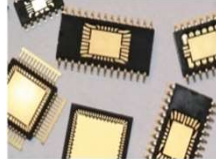
IC設計/光罩



IC設計除錯與找出IC故障真因，讓客戶產品快速Time to market

- 1.IC電路修補，讓designer找出設計錯誤點，並**確認更改設計的有效性**
- 2.IC量產後，針對不良品，進行電測/故障點標定/結構/成份分析
運用 EFA & PFA 技術**找出IC故障真因**

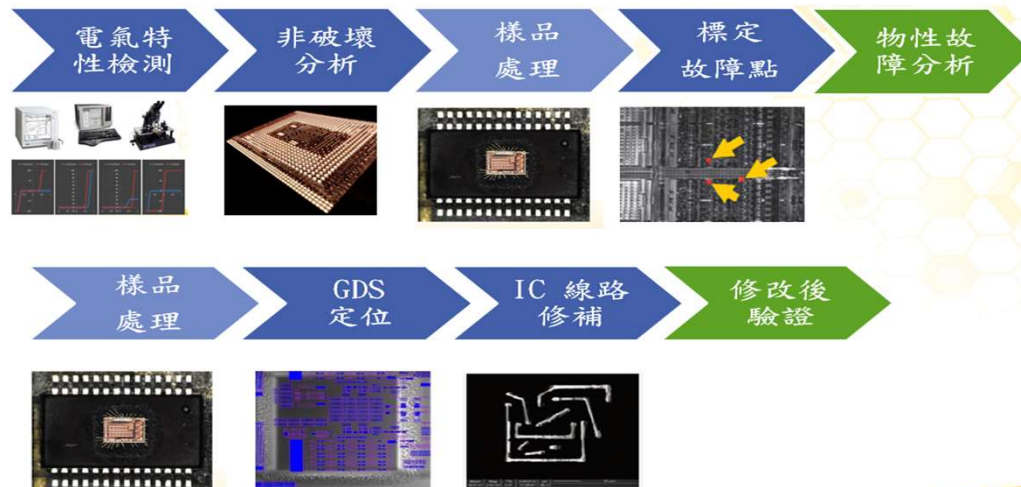
封測/載板/
軟板/PCB 等



汎銓的**低損傷分析技術**，從晶圓代工取得絕對優勢，擴展到半導體下游

- 1.材料多樣性/硬度差異/越做越薄/層和層結合力越來越弱
- 2.開發一系列保護試片專利，減少熱和電的影響，避免產生**人為缺陷**

故障分析
流程



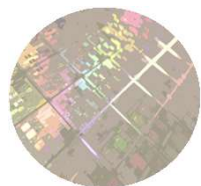
沉銓在半導體產業鏈扮演的角色-MA

項目&定位

內 容

材料分析
服務

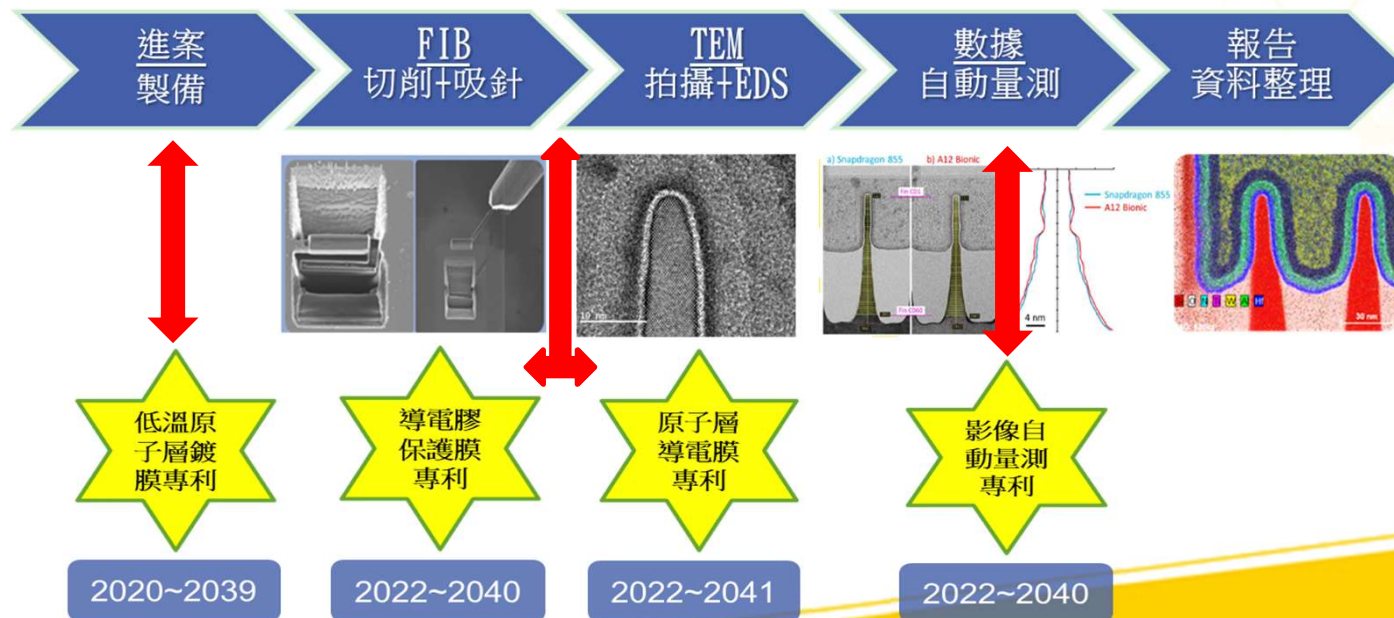
(研發領航者)



晶圓代工/設備/材料

提供電晶體結構與成份分析，讓FAB 快速達成以下任務
沉銓技術停滯或速度變慢，我們的客戶研發時程就會延誤！
 1.研發最先進製程，決定 **新設備的機型/新材料/製程參數**
 2.導入量產，新建產線的機台，必須證明與RD line 一致性
 3.量產中，產線持續良率提昇

材料分析
流程



專利名稱

專利期間

合併綜合損益表

(新台幣/千元)	2024Q2	2023Q2	YoY
勞務收入	509,291	503,609	1.13%
營業毛利	160,312	194,711	(17.67%)
毛利率 %	31	39	
營業費用	(88,810)	(84,459)	5.15%
營業外收支	(10,271)	313	(3381.47%)
稅前淨利	61,231	110,565	(44.62%)
所得稅費用	(20,490)	(29,405)	(30.32%)
本期淨利	40,741	81,160	(49.8%)
EPS(元)	0.87	1.73	

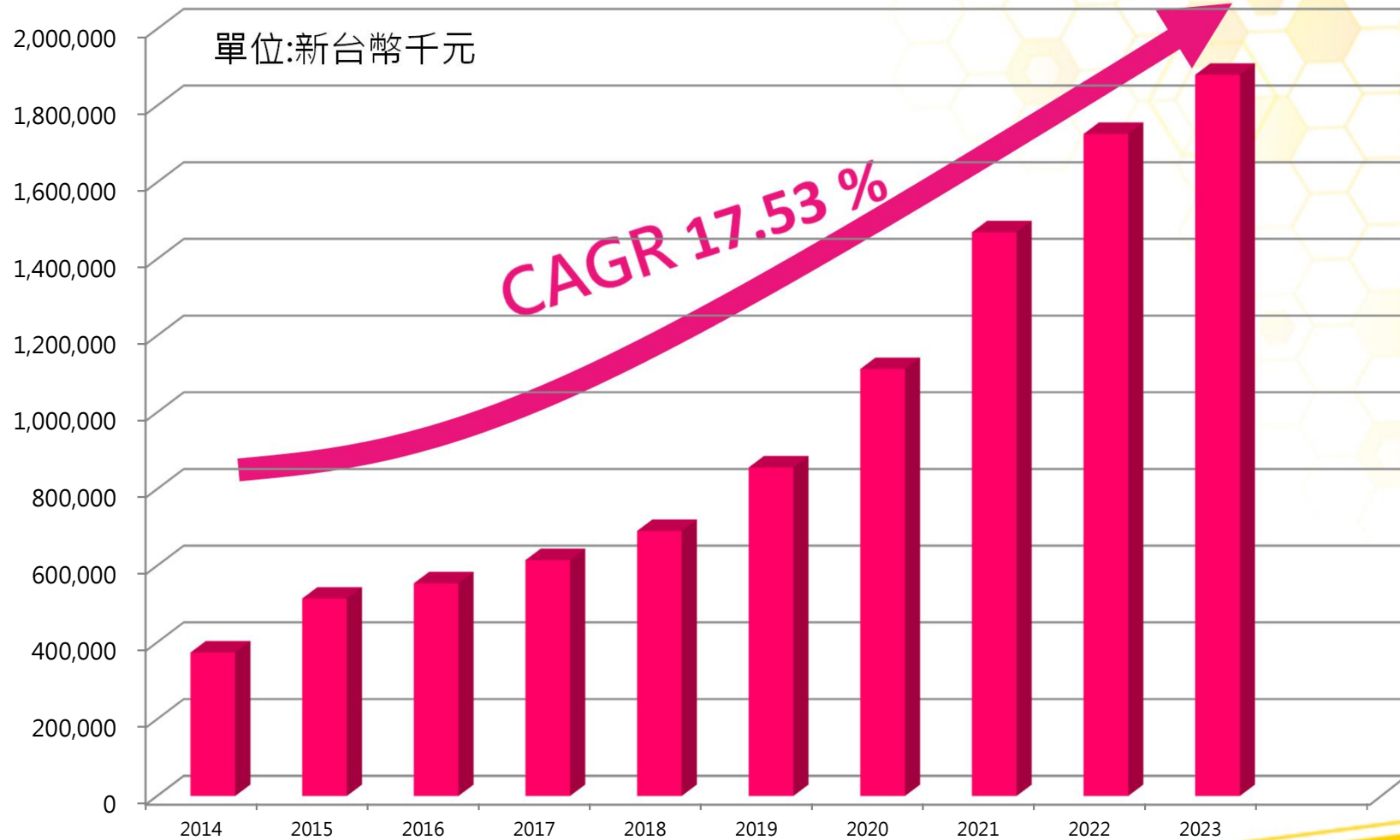
合併資產負債表

(新台幣/千元)	2024/06/30		2023/06/30	
	Amount	%	Amount	%
現金及約當現金	1,031,186	15%	1,059,003	27%
應收帳款	634,192	16%	699,911	18%
預付款項及其他流動資產	148,804	3%	105,791	3%
不動產、廠房及設備	2,697,145	51%	1,649,189	42%
使用權資產及其他非流動資產	760,236	15%	423,020	10%
資產總計	5,271,563	100%	3,936,914	100%
應付帳款及其他應付款	481,633	9%	517,464	13%
其他流動負債	805,496	15%	283,927	7%
長期借款	1,303,479	25%	587,009	15%
其他非流動負債	278,211	5%	131,347	4%
負債總計	2,868,819	54%	1,519,747	39%
權益總計	2,402,744	46%	2,417,167	61%

合併現金流量表

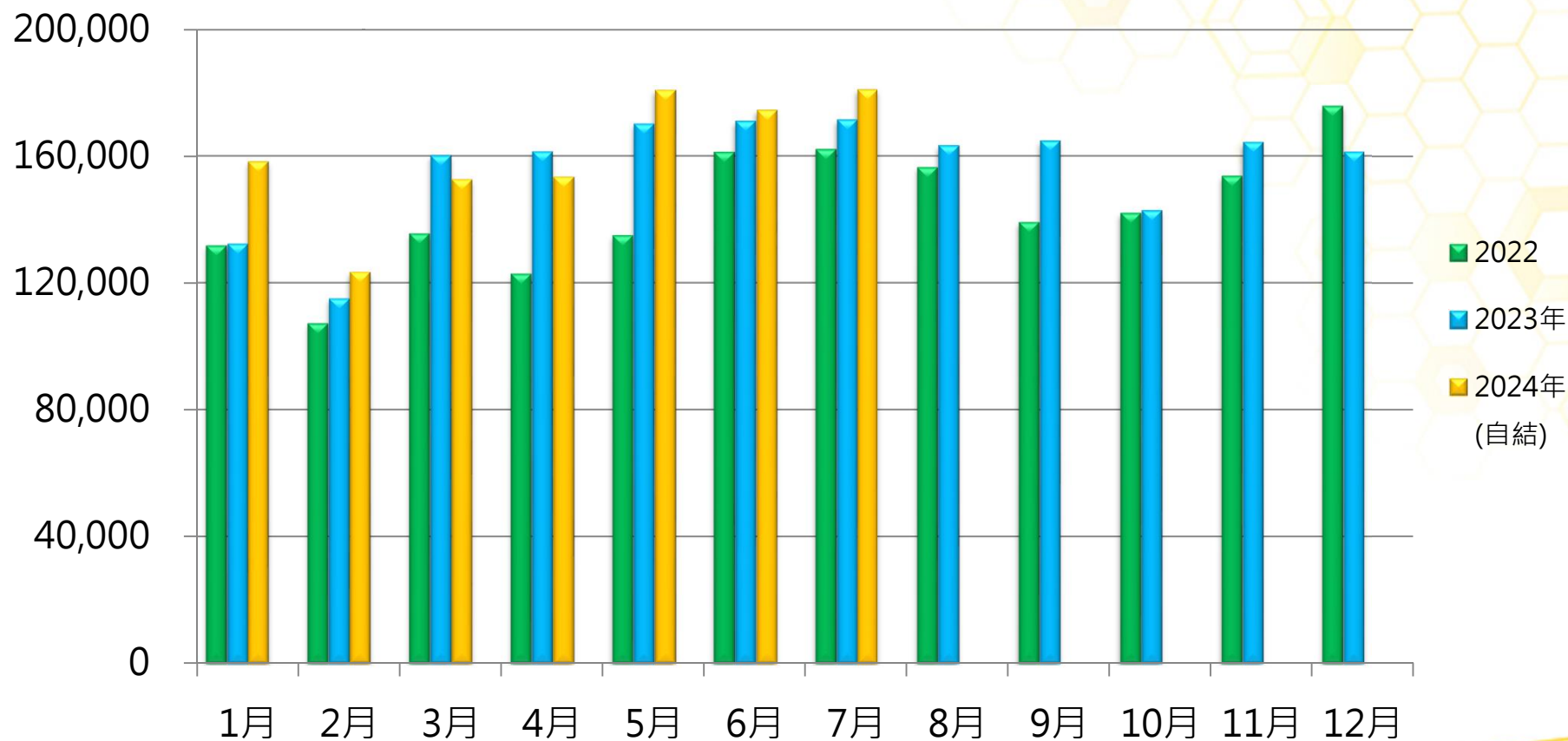
(新台幣/千元)	2024Q2	2023Q2
期初現金及約當現金餘額	622,110	1,113,271
營業活動之現金流量	359,099	273,034
購置不動產、廠房及設備	(950,506)	(302,237)
舉借長/短期借款	1,112,000	31,000
其他	(111,517)	(56,065)
期末現金及約當現金餘額	1,031,186	1,059,003

最近十年度營收成長趨勢

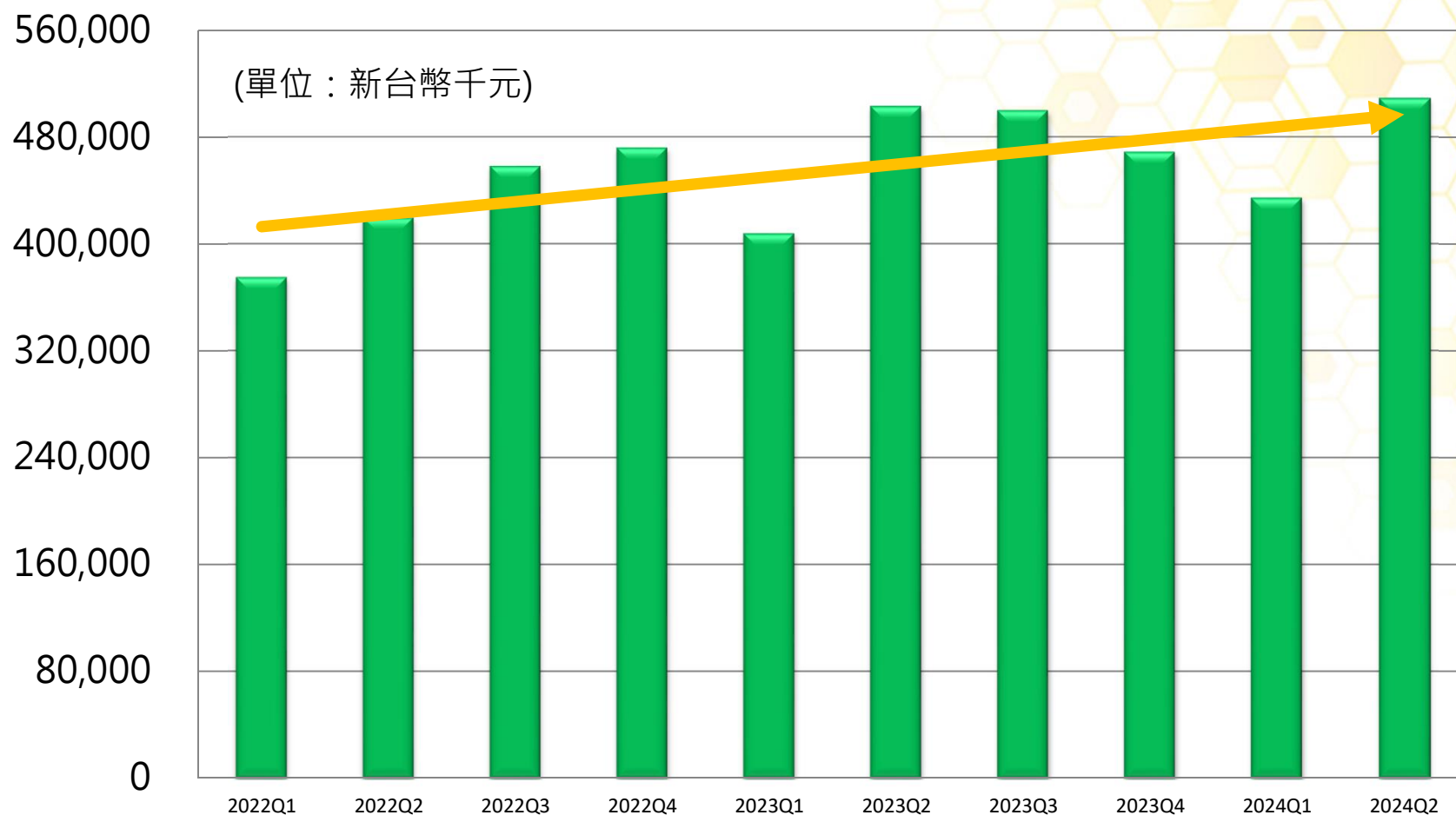


2022~2024年度 月營收趨勢

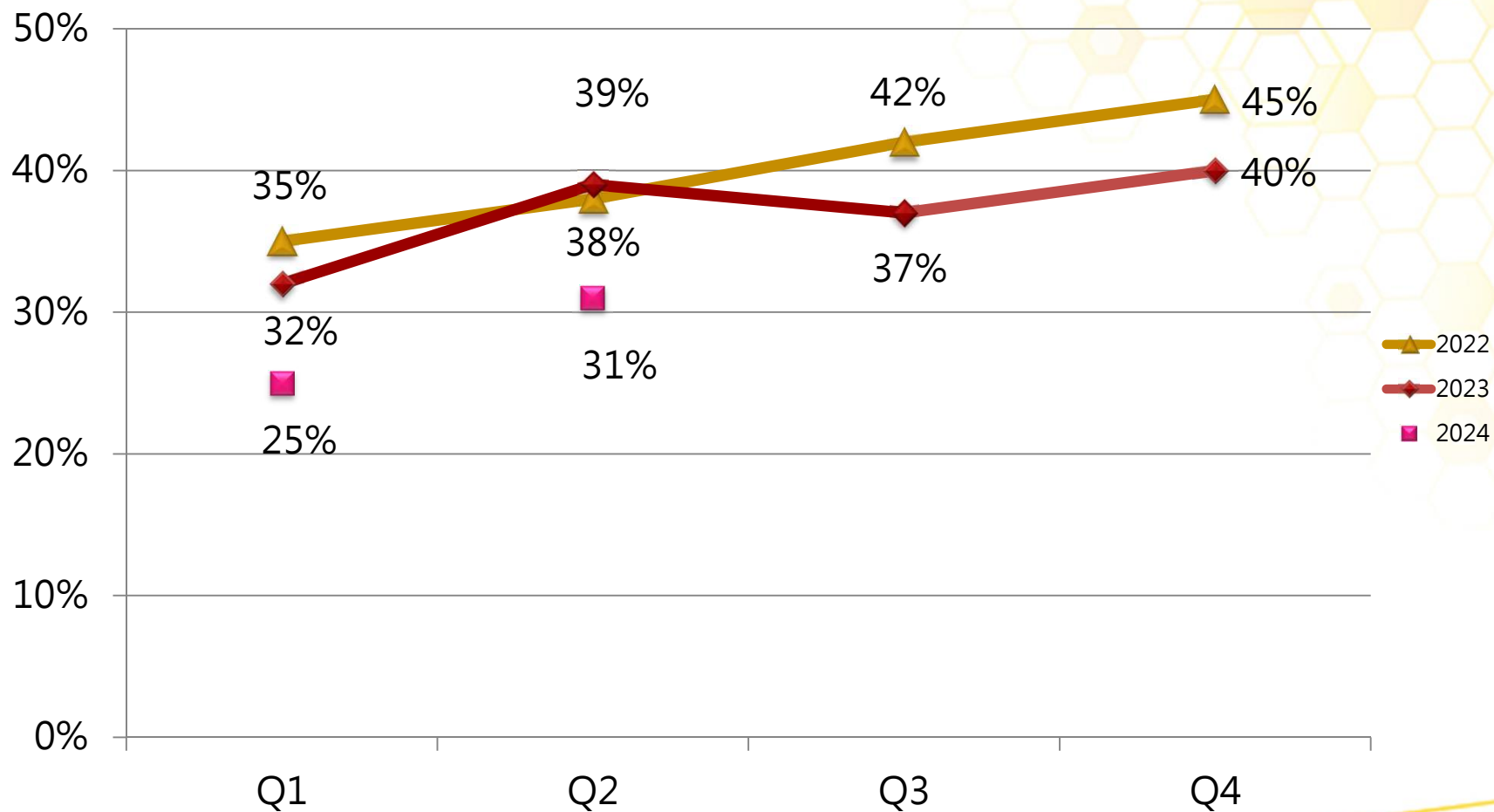
(單位：新台幣千元)



2022~2024年度 季營收趨勢

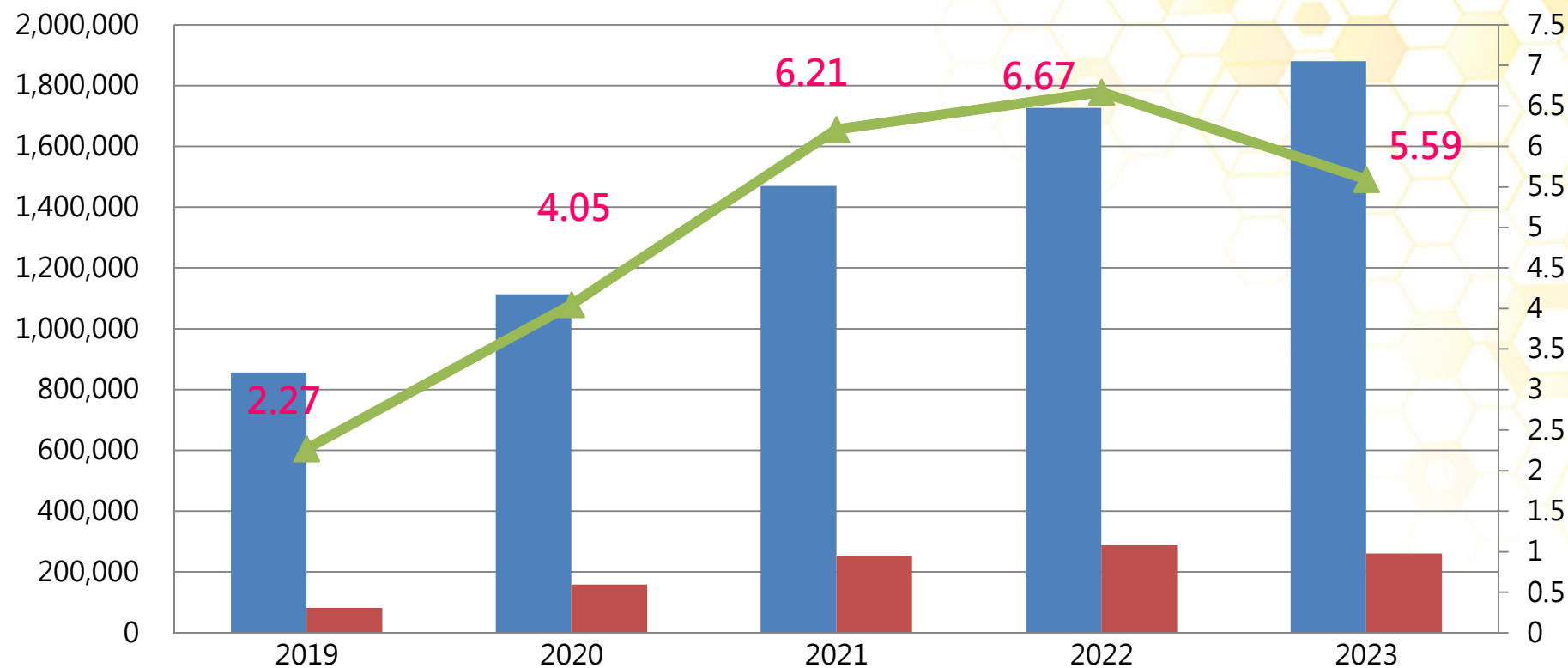


2022~2024年度 各季毛利率分析



最近五年度獲利表現與股利分配

單位:新台幣千元/元



營業收入	856,306	1,113,184	1,469,881	1,726,427	1,880,575
稅後純益	81,764	159,106	252,493	287,998	261,280
EPS	2.27	4.05	6.21	6.67	5.59
股利分配	2	2.5	4.5	5.5	4.5



感謝聆聽，敬請指導



Your best R&D partner

 1F,NO.27,Pu-ding Rd., Hsin-chu
30072,Taiwan,R.O.C

 +886-3-6663298

 service@msscorps.com